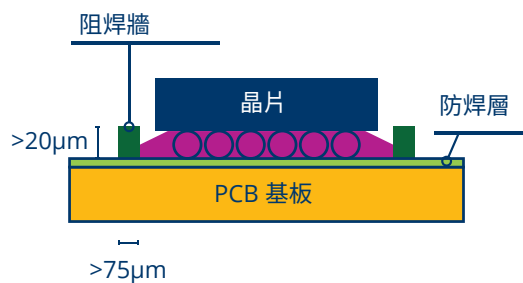


Orbotech Magna™

IC 封裝疊加噴印解決方案

更多的功能，更少的空間

微電子需求不斷增長促使了對成本效益的追求和阻焊牆位置的精確定位，這些阻焊牆在特定功能的晶片周圍形成屏障，以防止洩露。噴墨印刷提供了一種替代昂貴傳統防焊影像轉移或點膠機的方法，同時節省了封裝的空間。



Orbotech Magna 創建阻焊牆

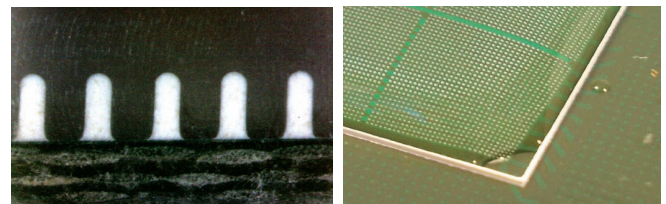
KLA的疊加噴印技術通過投放保護屏障來封閉晶片周圍的區域，使製造商得以節省空間和生產成本。通過使用 Orbotech Magna 噴印解決方案建造阻焊牆，其結果會比傳統工藝更精確、成本更低，Orbotech Magna 還節省了極其有限的封裝空間，適用於倒裝晶片規模封裝 (FCCSP)、球柵陣列 (BGA) 和先進的封裝晶片 (CIP) 模組。

- 先進的阻焊牆噴墨列印
- 支持高縱橫比的阻焊牆的放置——最高可達 0.5mm 高，75µm 寬
- 在不同的基材上提供優秀的附著力
- 支持 strip, 大板, JEDEC 托盤, 晶圓
- 高產能，低整體擁有成本 (TCO)
- 高精度放置可以減少阻焊牆隔離區 (KOZ)



Orbotech Magna - 絕緣層直接噴印

- 無原料浪費
- 去除昂貴的光刻步驟-簡化製程
- 無需光罩
- 總成本節約 40%
- 縮短新產品上市時間
- 適用於方形扁平無引腳封裝 (QFN) 及晶片級封裝(CSP)



傳統工藝耗時長，成本高



Orbotech Magna - 快速，成本效益，環保



規格

最大噴印面積	12" x 16" (304.8mm x 406.4mm)
最小/最大 板材厚度	4-256mil (0.1mm - 6.5mm)
最低/最高解析度	600 - 2400 dpi
最小線寬	2.9mil (75µm)
對位精確度 (FTG)	±1.4mil (±35µm)
最大距離 噴頭/基材	Up to 60mil (1.5 mm)
對位	用戶可選擇對位點; 分割漲縮
條狀/板材固定	標準：條狀板材 真空/夾具 選配：客製化載具、JEDEC 托盤、大板
軟體	軟體 RIP，CAM 軟體整合，Gerber RS-274X 輸入，一按即印，支援多種語言
油墨類型	由業界領先供應商提供的多款油墨
尺寸 (寬 x 深 x 高)*	39.4" X 45.3" X 88.2" (1000mm x 1150mm x 2240mm)
重量	1984lbs (900kg)
自動化	配備第三方自動化設備整合界面

* 高度包含了系統運行狀態警示燈塔高度

KLA 支持
保持系統生產力是 KLA 良率優化解決方案不可或缺的一部分。包括系統維護、全球供應鏈管理、降低成本和減少報廢、系統遷移、性能和生產率提升以及轉售認證設備。

KLA Corporation
www.orbotech.com/pcb | www.kla.com
Rev 3.0_6-13-2022

©2022 KLA Corporation 全球範圍內保留所有權利。KLA 保留無需通知而變更硬體和/或軟體規格的權利。Orbotech 是 KLA 公司 Orbotech Limited 的註冊商標。KLA 和 KLA 標識是 KLA Corporation 的註冊商標。所有品牌或產品名稱可能是各自公司的商標。